

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
【部門区分】第 7 部門第 2 区分
【発行日】令和 6 年 4 月 4 日(2024.4.4)

【公開番号】特開 2023-127609(P2023-127609A)
【公開日】令和 5 年 9 月 14 日(2023.9.14)
【年通号数】公開公報(特許)2023-174
【出願番号】特願 2022-31382(P2022-31382)
【国際特許分類】

H 0 1 L 23/34(2006.01)

10

【F I】

H 0 1 L 23/34 B

【手続補正書】
【提出日】令和 6 年 3 月 27 日(2024.3.27)
【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】0 0 0 3
【補正方法】変更
【補正の内容】

20

【0 0 0 3】
【特許文献 1】特開 2 0 1 2 - 1 4 2 4 6 5 号公報
【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】0 0 5 4
【補正方法】変更
【補正の内容】
【0 0 5 4】

図 8 に示すように、実施の形態 5 では、実施の形態 3 に対して半導体モジュール 1 0 は、複数（例えば 2 つ）の金属部材 1 3 を備えている。金属部材 1 3 と半導体素子 1 4 との接続関係は 2 つとも同じである。一方（図 8 において左側）の半導体素子 1 4 の上面電極はリード電極 1 5 の一端部と接合材 2 1 を介して接合され、他方（図 8 において右側）の半導体素子 1 4 の上面電極はリード電極 2 2 の一端部と接合材 2 1 を介して接合され、一方の半導体素子 1 4 が搭載された金属部材 1 3 の上面はリード電極 2 2 の他端部と接合されている。また、他方の半導体素子 1 4 は接続配線 1 7 を介してリード電極 1 6 の一端部と接続されている。なお、実施の形態 5 の構造を実施の形態 1 ~ 4 の構造に採用することも可能である。

30

40

50